

IQC 檢驗重點

料號	10HB3-736256-10R	品名規格	GDDR6 K4Z80325BC-HC14 SAMSUNG SMD FBGA180 256M*16*2CH 8GB
----	------------------	------	---

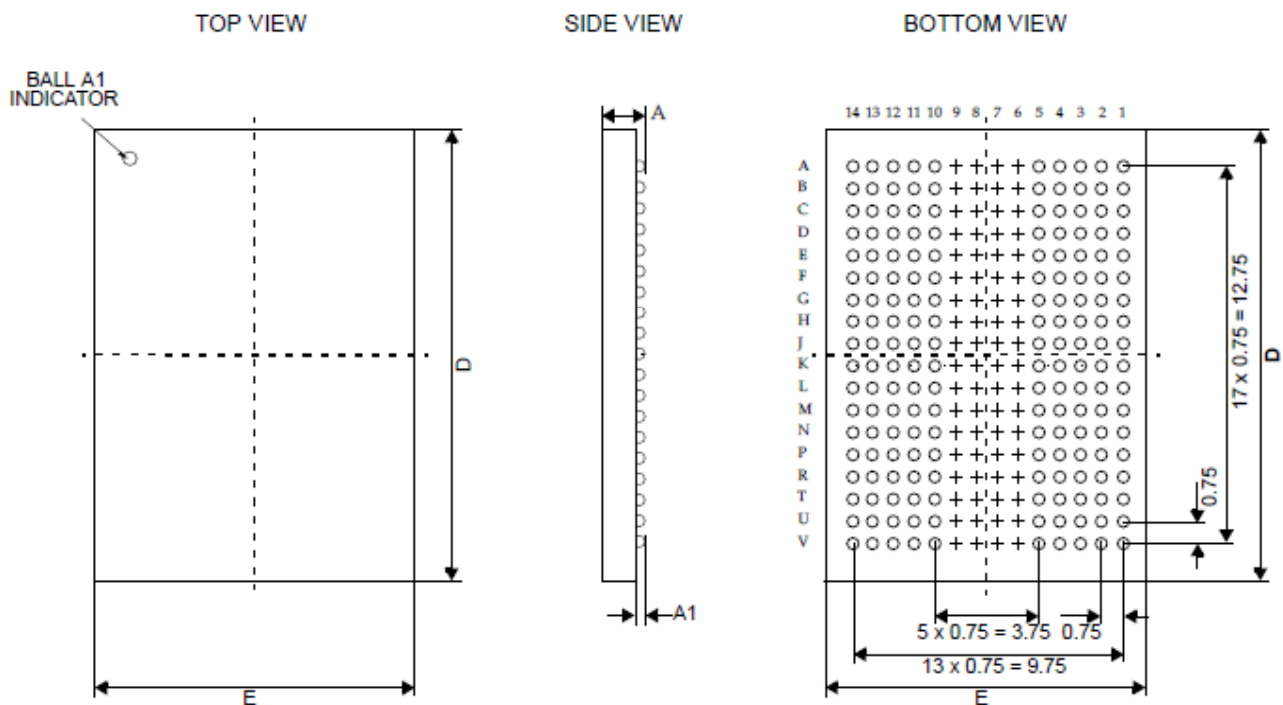
零件樣品圖：



外觀文字面檢驗重點：

1. SAMSUNG: Company Logo (不可變)
2. K4Z80325BC-HC14 : Part Number (不可變)
3. 819: Date Code(可變)
4. ●: PIN1(不可變)
5. G6A0050E : Lot Number (可變)
6. 二維碼

機構尺寸工程圖：



Parameter	Symbol	Minimum	Nominal	Variation
Length	D		14.00	+/- 0.100
Width	E		12.00	+/- 0.100
Height	A		1.10	+/- 0.100
Ball diameter	b		0.48	+/- 0.050
Standoff	A1	0.24		
Ball pitch	e		0.75	

NOTE :

- 1) GDDR6 package size, height and standoff specification is compliant to MO-328, Variation P14.0x12.0-GJ-180A
- 2) All dimensions in mm unless otherwise noted.

IQC電氣、機構檢驗重點：

1. 量測各部尺寸須與規格值相符.
2. 檢視產品外觀，表面無異物，且不得有任何破損及變形.

Part Number	Max Freq.	Max Data Rate	VDD & VDDQ	Interface	Package
K4Z80325BC-HC16	2000Mhz	16.0Gbps/pin	1.35V +/- 0.0405V	POD_135	180 Ball FBGA
	1750Mhz	14.0Gbps/pin	1.25V +/- 0.0375V	POD_125	
K4Z80325BC-HC14	1750Mhz	14.0Gbps/pin	1.35V +/- 0.0405V	POD_135	
	1500Mhz	12.0Gbps/pin	1.25V +/- 0.0375V	POD_125	
K4Z80325BC-HC12	1500Mhz	12.0Gbps/pin	1.35V +/- 0.0405V	POD_135	
	1250Mhz	10.0Gbps/pin	1.25V +/- 0.0375V	POD_125	

μ-EDX 有害物質檢測：

μ-EDX 需依照HCSR 有害物質管制規範實施檢測，並參照IQC EDX Test Guide 規範。

Date：2018/09/12	Rev. 00	首次發行
-----------------	---------	------